

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	UBS Securities 俞佳 Aspex Management Steven Liu
时间	2024年7月17日 15:30-16:30
地点	北京经济技术开发区科创八街21号院 赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 503 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：张阿斌 证券事务代表：孙玉华 证券投关经理：刘妍君 证券事务助理：甘世延、林彦凌
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：公司介绍 上市公司介绍了公司的基本情况、发展历程、核心业务、产业角色、全球化布局、发展战略、商业模式、竞争格局等。在经历重大战略转型后，赛微电子已专注 MEMS 芯片制造主业，当前核心工作就是持续提升境内外产线的产能、利用率及良率，公司看好智能传感行业的未来发展空间，同时对自身的芯片制造工艺及综合竞争实力充满信心。 第二部分：上市公司解答提问，主要如下：

1、公司如何看待 MEMS 行业的纯代工模式及 IDM 模式？

答：在我们看来，每家公司的业务发展模式都是根据自身的业务情况确定的，公司非常尊重各类厂商（包括客户）自身的战略考虑。但同时我们也应看到，半导体制造产线的建设具有长周期、重资产投入的特点，且某单一领域设计公司投资建设的自有产线一方面较难为同类竞争设计公司服务，另一方面产线向其他产品品类拓展的难度也较大。而公司是专业的纯代工企业，基于长期的工艺开发及生产实践，在同类产品的代工业务方面能够积累较好的工艺技术，在制造环节具有产品迭代和成本控制方面的服务优势，Fabless（无晶圆厂）模式或 Fablite（轻晶圆厂）设计公司与我们合作，可以避免巨大的固定资产投资，可以将资源更多地专注在产品设计及迭代方面，并参与市场竞争。

公司的商业模式为纯 MEMS 代工厂商，根据客户提供的 MEMS 芯片设计方案，进行优化反馈、工艺制程开发以及提供完整的 MEMS 芯片制造服务，公司及子公司在过去 20 多年已在行业内树立了不涉足芯片设计、无自有品牌、专注工艺开发及晶圆代工、严密保护知识产权的企业形象，最大程度地避免了因与客户业务冲突导致出现 IP 侵权的道德及法律风险，增加了客户的认同感及信任度。客观而言，从过去到未来，大量 Fabless（无晶圆厂）或 Fablite（轻晶圆厂）设计公司出于对自身 MEMS 专利技术保护的考虑，倾向于将其 MEMS 生产环节委托给纯代工厂商，也反映了专业分工的趋势，台积电（TSMC）所获得的巨大成功也是半导体专业分工趋势的例证和参考。

综合而言，IDM 模式与 Fabless 或 Fablite 模式（对应与纯 Foundry 厂商合作）相比各有优劣，将会是业界长期共存的商业发展模式。

2、请问公司如何看待 MEMS 的市场规模？

答：随着万物互联与智能传感时代的到来，物理世界与数字世界需要相互连接的桥梁，无论科技及应用如何发展，均离不开对真实世界的感知，人、设备、自然世界之间及内部各自之间的感知、联系均需要通过声、热、光、电、磁、运动等等各种基础器件来辅助实现，基础感知及执行器件的应用场景将越来越丰富，通过半导体工艺批量标准化制造的 MEMS 芯片，具备小型化、低成本、低功耗、高集成度等突出特点，正在对部分传统传感器件进行渗透及替代，拥有良好的发展前景。

根据 Yole Development 的研究预测，全球 MEMS 行业市场规模将从 2021 年的 136 亿美元增长至 2027 年的约 223 亿美元，复合增长率（CAGR）达 9%，通讯、生物医疗、工业汽车及消费电子的应用增速均非常可观，其中通讯领域的复合增长率高达 25%。预计到 2026 年，10 亿美元以上的 MEMS 细分领域包括射频 MEMS（40.49 亿美元）、MEMS 惯性器件（40.02 亿美元）、压力 MEMS（23.62 亿美元）、麦克风（18.71 亿美元）以及未来应用（13.63 亿美元）。

由于公司自身 MEMS 业务突出的竞争优势，近年来所取得的复合增长率远远超过了行业平均增速，这也是我们持续扩充产能的信心来源，希望能通过新增产能与市场需求相结合，将公司所积累的工艺优势充分发挥出来。作为一家具备全球一流水平的专业芯片制造厂商，我们需要做的是持续不断地丰富和提升芯片制造工艺水平、持续不断地在全球范围内扩充中试及规模产能，顺应万物互联与人工智能时代的发展及需求爆发。

3、请问公司 MEMS 业务的整体收入结构及变化趋势如何？

答：公司 MEMS 业务的收入结构主要包括通讯、生物医疗、工业汽车和消费电子四大领域，收入结构受客户及终端市场需求的变动所影响。

根据过去长期的业务数据统计，MEMS 在各领域的制造需

求均在增长,但不同业务领域在不同时期会产生一些明显的波动,比如 4G 和 5G 的发展刺激了通讯领域的需求;诊断及检测刺激了生物医疗领域的需求;汽车智能化、元宇宙兴起又带动了车载 MEMS 器件、AR/VR/MR 传感器等相关硬件的新需求。

公司的角色是 MEMS 晶圆制造厂商,为下游各领域客户提供优质的工艺开发及晶圆制造服务。基于 MEMS 平台工艺制造的各类智能传感系统是万物互联、人工智能时代背景下可以被广泛应用的基础器件,结合业务实践,公司长期看好下游各领域的未来需求。

4、请问公司 MEMS 业务的客户分布情况如何?

答:公司 MEMS 客户遍布全球,从北美科技之都到英伦学术重镇,从欧洲制造强国到亚洲新兴经济,从尖端生命科学到日常娱乐消费,从成熟行业巨头到创新创意团队,产品覆盖了通讯、生物医疗、工业汽车、消费电子等诸多领域。公司欢迎与全球各领域大小客户、科研机构及高等院校开展技术与业务合作。

5、请问公司与境内其他 MEMS 厂商相比,业务上是否存在差异性,竞争优势和劣势有哪些?

答:在当前竞争格局下,公司在 MEMS 芯片工艺开发及晶圆制造方面已经深耕超过二十年,存在着显著的竞争优势,主要如下:(1)突出的全球市场竞争地位;(2)先进的制造及工艺技术,掌握了多项在业内极具竞争力的工艺技术和工艺模块;(3)标准化、结构化的工艺模块;(4)覆盖广泛、积累丰富的开发及代工经验;(5)产业长期沉淀、优秀且稳定的人才团队;(6)丰富的知识产权;(7)中立的纯晶圆厂模式;(8)前瞻布局、陆续实现的规模产能与供应能力。

公司截至目前的劣势也较为明显,即整体产能及营收规模较小,短期内尚缺乏规模效应,工艺优势尚未得到完全发挥和

	<p>体现，境内产线团队仍需要通过量产实践加以磨练。相比其他排名领先的代工厂商以及中国境内的新兴厂商，虽然瑞典 Fab1&2 与北京 Fab3 到目前为止尚未充分展现规模量产能力，但在 MEMS 工艺技术的广度及深度方面，以及产品及客户积累等方面，均能体现出巨大的、待释放的发展潜力。当然中国境内外的许多 MEMS 厂商也非常优秀、具备不同的特点，且由于整个 MEMS 产业仍处于早期发展阶段，发展空间巨大，业内厂商均可以拥有充足的发展机遇。</p> <p>6、请问公司 MEMS 业务收入是否受到季节性、淡旺季的影响？</p> <p>答：根据公司历史统计数据，MEMS 业务收入的季节性、淡旺季并不明显。虽然不同季节会因所交付芯片晶圆的结构差异而产生波动，但由于偏居上游，涉及下游各行业较为分散，来自不同领域的需求增减会在一定程度上相互抵消，因此 MEMS 业务的周期性较弱。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 7 月 17 日